## 06;07 Высокотемпературный диод на основе эпитаксиальных слоев GaP

## © М.М. Соболев, В.Г. Никитин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

## Поступило в Редакцию 22 октября 1997 г.

Сообщается о получении чистого, нелегированного, высокотемпературного GaP, выращенного методом жидкофазной эпитаксии. Приведены результаты исследований p-n-структур GaP, выращенных при различных температурах начала кристаллизации, с помощью вольт-фарадного метода (C-V) и нестационарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS). Полученные характеристики GaP определяются низким уровнем концентрации фоновой примеси и дефектов с глубокими уровнями. Измерения температурной зависимости прямой ветви вольт-амперной характеристики показали, что термометрическая характеристика диода линейна в диапазоне температур от -191 до  $\sim +600^{\circ}$ С.

GaP в настоящее время широко используется для создания светодиодов в видимой области света. Широкозонный GaP можно рассматривать также и как перспективный материал для создания высокотемпературных электронных приборов и фотоприемников [1]. Однако его применение сдерживается из-за трудностей получения сравнительно чистого GaP с уровнем фоновой примеси и концентрацией точечных дефектов с глубокими уровнями соответственно меньше  $10^{16}$  сm<sup>-3</sup> и  $10^{14}$  cm<sup>-3</sup>. И лишь сравнительно недавно появились работы, в которых сообщается о получении GaP с концентрацией остаточной донорной примеси порядка  $10^{14}-10^{15}$  cm<sup>-3</sup> [2–3]. Низкий уровень остаточных примесей является важным, но не единственным условием для получения высокотемпературного GaP. Другим не менеее значительным критерием, опреде-

1

ляющим получение высокотемпературного и термостабильного GaP, является наличие точечных дефектов с глубокими уровнями, которые образуются в процессе эпитаксиального роста GaP. Как известно [4], собственные свойства GaP, концентрация и наличие дефектов, а также характер поведения фоновых примесей в нем определяются степенью отклонения от стехиометрического состава и соответственно областью гомогенности, которые зависят от температуры кристаллизации. Отсюда понятна необходимость в проведении исследований качества эпитаксиальных нелегированных слоев GaP: концентрации свободных носителей и дефектов с глубокими уровнями в зависимости от технологических условий выращивания эпитаксиальных слоев, в частности от температуры начала кристаллизации.

В данной работе сообщается о получении чистого, нелегированного, высокотемпературного GaP. Приведены реузльтаты исследований p-n-структур GaP с помощью вольт-фарадного метода (C–V) и нестационарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS). Кроме того представлена термометрическая характеристика диодной структуры GaP.

Слои *n*-GaP. были вырашены метолом жилкофазной эпитаксии при охлаждении раствора-расплава Ga-P с постоянной скоростью 0.1-0.3°С/тіп. В качестве подложек использовали пластины GaP nи *p*-типа проводимости с концентрацией носителей  $\sim 10^{18} \, \mathrm{cm}^{-3}$ , ориентированные в плоскости [100] и полученные методом Чохральского. Процесс эпитаксиального роста проводили в потоке водорода с точкой росы -65°C при температурах начала кристаллизации 700-950°C. Толщины эпитаксиальных слоев были порядка 5-20 µm. Легированные эпитаксиальные слои  $n^+$ -типа в структурах  $p^+ - n^0 - n^+$ - и  $p^+$ -типа в структурах  $n^+ - n^0 - p^+$  получали при введении в расплавы Si и Mg соответственно. Измерения эффекта Холла проводились четырехзондовым методом на слоях, выращенных на полуизолирующих подложках GaP. C-V и DLTS измерения делались с помощью DLTS 4600 спектрометра фирмы Bio-Rad. Наличие *р*-*n*-структуры позволило нам проводить исследования глубоких ловушек как основных, так и неосновных носителей, подавая на образец соответствующие импульсы заполнения. Длительность импульсов заполнения 5 ms. Температура образца в криостате сканировала от 80 до 450 К. Энергия термической активации E и сечение захвата  $\sigma$  определялись с помощью зависимости Аррениуса T/e от 1000/T, где е — темп эмиссии электронов и дырок, *T* — температура максимума пика DLTS спектра. Концентрации

дефектов и примесей с глубокими уровнями определяли из соотношения  $N_t = 2(N_d - N_a)|\Delta C|_m/C_0$ , где  $(N_d - N_a)$  — концентрация нескомпенсированных мелких донорных уровней,  $|\Delta C|_m$  — высота DLTS пика,  $C_0$  — стационарная емкость обедненного слоя при соответствующих напряжениях обратного смещения.

На рис. 1 а. в приведены зависимости изменения концентрации свободных электронов и их подвижности в нелегированных эпитаксиальных  $n^0$ -слоях GaP, определенные с помощью эффекта Холла и C-V измерений, от температуры начала кристаллизации T<sub>0</sub>. Результаты холловских измерений показали, что коэффициент компенсации в исследуемых нами эпитаксиальных n<sup>0</sup>-слоях GaP не превышает 0.5, и поэтому концентрация мелких доноров  $N_d$  много больше, чем концентрация акцепторов  $N_a$ и  $n = (N_d - N_a) \cong N_d$ . Из приведенных на рис. 1 результатов следует, что с ростом T<sub>0</sub> концентрация свободных электронов в слоях падает, а их подвижность соответственно растет. Диапазон изменения концентрации свободных электронов в слоях от  $1.5 \cdot 10^{17} \, \mathrm{cm}^{-3}$  до  $7 \cdot 10^{14} \, \mathrm{cm}^{-3}$ . Подвижность электронов при комнатной температуре в слоях GaP, выращенных при  $T \cong 900^{\circ}$  С, была 200–250 cm<sup>2</sup>/V · s. При температуре жидкого азота значение подвижности увеличивалось на порядок. В наиболее чистых образцах с  $n \approx 5 \cdot 10^{14} \,\mathrm{cm}^{-3}$  ее величина достигала  $3000 \,\mathrm{cm}^2/\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}$ . Проведенные на этих образцах DLTS измерения показали наличие низкого уровня концентрации дефектов с глубокими уровнями. Их минимальная концентрация N<sub>t</sub> наблюдалась для T<sub>0</sub> = 800°C и была равна  $3.5 \cdot 10^{12} \,\mathrm{cm}^{-3}$  (рис. 1, *a*). DLTS спектр для образца с температурой  $T_0 = 800^{\circ}\mathrm{C}$  представлял собой сплошную широкую полосу во всем температурном диапазоне DLTS измерений, связанную с основными носителями, в котором каких-либо уровней выделить не удалось. При повышении T<sub>0</sub> до 900°C концентрация дефектов с глубокими уровнями увеличивалась (рис. 1, a). В спектрах DLTS можно было выделить два отдельных пика, связанных с дырочными ловушками (рис. 2). Параметры уровней были соответствнно FH1 = 290 meV,  $\sigma_p = 6.1 \cdot 10^{-17} \,\mathrm{cm}^2$  и FH2 = 649 meV,  $\sigma_p = 3.0 \cdot 10^{-11} \,\mathrm{cm}^2$ . При  $T_0 = 950^{\circ}$ С происходил дальнейший рост концентрации ловушек неосновных носителей (рис. 1, a). В DLTS спектре (рис. 2), так же как и для предыдущего случая, можно было выделить два пика, связанных с дырочными ловушками, но с другими параметрами: FH3 - 106 meV,  $\sigma_p = 3.7 \cdot 10^{-21} \,\mathrm{cm}^2$  и FH4 = 807 meV,  $\sigma_p = 4.8 \cdot 10^{-13} \,\mathrm{cm}^2$ . Дырочные ловушки FH2 и FH4 были подобны H3 и H7 уровням соответственно, которые ранее наблюдались в GaP, выращенном методом жидкофазной



**Рис. 1.** a — зависимости концентрации свободных электронов (n), определенных с помощью C-V измерений (1) и эффекта Холла (2), а также дефектов с глубокими уровнями в нелегированных эпитаксиальных *n*-слоях GaP от температуры начала кристаллизации  $T_0$ ; b — зависимости подвижности электронов в нелегированных эпитаксиальных *n*-слоях GaP, определенные при азотной  $(n^{77K})$  (1) и комнатной температурах  $(n^{300K})$  (2) от температуры начала кристаллизации  $T_0$ .



**Рис. 2.** DLTS спектры нелегированных эпитаксиальных *n*-слоев GaP, выращенных при температуре начала кристаллизации 800°C (1), 900°C (2) и 950°C (3).

эпитаксии [5]. Природа их не была установлена. В этой же работе [5] отмечается, что электронных ловушек замечено не было, что характерно для GaP, полученного из раствора-расплава фосфора в галлии. Для  $n^+ - n^0 - p^+$ -структуры, полученной при  $T_0 = 800^{\circ}$ С, была измерена зависимость прямых падений напряжения на диоде от температуры при пропускании постоянного тока (100 mA) в интервале от 191 до ~ 600°С. Из рис. З следует, что термометрическая характеристика диода при его включении в прямом направлении линейна во всем исследуемом диапазоне температур.

Обсудим полученные результаты исследования зависимости изменения концентрации электронов и дефектов с глубокими уровнями от температуры начала кристаллизации. Концентрация электронов в нелегированных слоях падает с ростом температуры начала кристаллизации, а их подвижность соответственно растет. Вероятной причиной наблюдаемых изменений этих величин может быть то, что основными остаточными примесями в GaP являются мелкие летучие доноры S, Se, Te. Высокая



**Рис. 3.** Зависимость прямых падений напряжения на GaP диоде от температуры при пропускании постоянного тока (100 мА).

концентрация электронов в слоях, полученных при относительно низких температурах роста, может быть связана с неполной очисткой расплава от летучих примесей. При дальнейшем повышении  $T_0$  улучшаются условия очистки от этих примесей и происходит уменьшение концентрации свободных электронов в эпитаксиальных слоях GaP. Наблюдаемый рост концентрации дырочных ловушек (рис. 1, *b*) с увеличением температуры начала кристаллизации в эпитаксиальных слоях GaP находится в соответствии с результатами теоретических оценок теплот образования дефектов [6]. Они показывают, что с ростом  $T_0$  при выращивании GaP из раствора–расплава P в Ga увеличивается сдвиг от стехиометрического состава GaP в сторону Ga, который и должен приводить к росту концентрации дефектов V<sub>P</sub> и Ga<sub>p</sub> либо их вакансионного комплекса  $V_pGa_pV_p$ .

Таким образом, результаты наших исследований показывают, что, выращенные методом жидкофазной эпитаксии слои GaP могут служить основой для создания приборов, работающих при экстремально высоких

температурах вплоть до 600°С, что не может быть получено при использовании таких традиционных материалов, как Si и GaAs. Полученные характеристики GaP определяются низким уровнем концентрации фоновой примеси и дефектов с глубокими уровнями, что обеспечивало линейность термометрической характеристики диода при его включении в прямом направлении во всем исследуемом диапазоне температур.

## Список литературы

- [1] Zipperian Th.E., Chaffin R.J., Dawson L.R. // IEEE Trans. on Ind. ELectron. 1982. IE-29. P. 129.
- [2] Weichold W.H. // Solid State Electron. 1985. V. 28. P. 957.
- [3] Brunwin R.F., Dean P.J., Hamilton B., Holdgkinson J., Peaker A.R. // Solid State Electron. 1981. V. 24. P. 249–256.
- [4] Andreev В.М., Долгинов Л.М., Третьяков Д.Н. Жидкостная эпитаксия в технологии полупроводниковых приборов. М.: Сов. радио, 1975.
- [5] Monney P.M., Kennedy T.A., Small M.B. // Physica. 1983. 116B. P. 431.
- [6] Van Vechten J.A. // Handbook on Semiconductors. Materials Properties, and Preparation. V. 3. T.S. Moss and S.p. Keller, Editors. North–Holland, Amsterdam, 1980. P. 1–11.